

Приказ / Order № 796

Об утверждении тарифов на работы (услуги) Центра коллективного пользования «Чистые помещения для микро- и нанообработки» для внутренних заказчиков Сколтеха/ On approval of cost for services (works) for internal customers of the Micro- and Nanofabrication Cleanroom Shared Facility

В целях утверждения Тарифов Центра коллективного пользования «Чистые помещения для микро- и нанообработки» Сколковского института науки и технологий для внутренних заказчиков Сколтеха,

In order to approve the Tariffs of the Micro- and Nanofabrication Cleanroom Shared Facility of the Skolkovo Institute of Science and Technology for internal customers,

ПРИКАЗЫВАЮ:

I HEREBY ORDER:

1. Утвердить Тарифы на услуги (работы) Центра коллективного пользования «Чистые помещения для микро- и нанообработки» для внутренних заказчиков (далее – Тарифы) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Приказу (далее – Приказ).

1. To approve the Tariffs for Services (works) for internal customers of the Micro- and Nanofabrication Cleanroom Shared Facility (hereinafter – Tariffs) in accordance with Appendix No. 1 to the present Order (hereinafter – Order).

2. Довести содержание настоящего Приказа до сведения руководителя Центра коллективного пользования «Чистые помещения для микро- и нанообработки» Габидуллина Айдара Радиковича.

2. To inform Head of the Micro- and Nanofabrication Cleanroom Shared Facility Gabidullin Aidar Radikovich on the contents of the present Order.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

3. The execution of the present Order will be followed up by me personally.

**Вице-президент по исследовательской инфраструктуре /
Vice President for Research Infrastructure**

**А.А. Денисов
A.A. Denisov**



**Тарифы на работы (услуги)
Центра коллективного пользования «Чистые помещения для микро- и
нанообработки»
для внутренних заказчиков /
Tariffs for works (services)
of the Micro- and Nanofabrication Cleanroom Shared Facility
for internal customers**

№	Наименование блока работ ¹ / Name of services ¹	Единица измерения / Unit of measurement	Стоимость, руб, без НДС ² / Tariff, RUB, no VAT ²
Типовые услуги участка планарных технологий / Typical services of the planar technology section			
1	Услуга по прецизионной резке технологических подложек на отдельные чипы / Precision dicing of technological substrates into individual chips	1 образец / 1 sample	14 100.00
2	Услуга по прецизионной резке технологических подложек на отдельные чипы в несколько закреплений / Precision dicing of technological substrates into individual chips in several clamping operations	1 образец / 1 sample	24 300.00
3	Услуга по прецизионной резке технологических подложек на отдельные чипы с пробоподготовкой / Precision dicing of technological substrates into individual chips with sample preparation	1 образец / 1 sample	23 100.00
4	Услуга по прецизионной резке технологических подложек на отдельные чипы с подбором режима / Precision dicing of technological substrates into individual chips with mode selection	1 образец / 1 sample	62 000.00
5	Услуга по лазерной обработке технологических подложек / Laser processing service for technological substrates	1 образец / 1 sample	8 000.00
6	Услуга по лазерной обработке технологических подложек с подбором режима / Laser processing service for technological substrates	1 образец / 1 sample	40 300.00

	with mode selection		
7	Услуга по формированию слоя SiO ₂ /Si ₃ N ₄ методом PECVD (Plasma-enhanced chemical vapor deposition) / SiO ₂ /Si ₃ N ₄ layer deposition by PECVD (Plasma-enhanced chemical vapor deposition) method	1 запуск / 1 run	34 500.00
8	Услуга по формированию слоя Al методом магнетронного распыления (Magnetron Sputtering) / Al layer deposition by Magnetron Sputtering method	1 запуск / 1 run	32 400.00
9	Услуга по формированию слоя Al методом электронно-лучевого испарения EBE (Electron beam evaporation) / Al layer deposition by EBE (Electron beam evaporation) method	1 запуск / 1 run	25 900.00
10	Услуга по формированию слоя Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , TiO ₂ , Ta ₂ O ₅ методом электронно-лучевого испарения EBE (Electron beam evaporation) / Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , TiO ₂ , Ta ₂ O ₅ layer deposition by EBE (Electron beam evaporation) method	1 запуск / 1 run	25 900.00
11	Услуга по формированию слоя Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , TiO ₂ , Ta ₂ O ₅ методом электронно-лучевого испарения EBE (Electron beam evaporation) с применением нагрева подложки / Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , TiO ₂ , Ta ₂ O ₅ layer deposition by EBE (Electron beam evaporation) method with substrate heating	1 запуск / 1 run	39 500.00
12	Услуга по созданию топологического рисунка в слое фоторезиста на подложке 100 мм с подбором режима / Creating a topological pattern in a photoresist layer on a 100 mm substrate with mode selection	1 образец / 1 sample	85 500.00
13	Услуга по созданию топологического рисунка в слое фоторезиста на подложке 100 мм / Creating a topological pattern in a photoresist layer on a 100 mm substrate	1 образец / 1 sample	39 800.00
14	Услуга по формированию слоя фоторезиста на подложке 100 мм / Formation of a photoresist layer on a 100 mm substrate	1 образец / 1 sample	7 000.00
15	Услуга по формированию слоя фоторезиста на подложке 200 мм / Formation of a photoresist layer on a 200 mm substrate	1 образец / 1 sample	8 500.00

**Типовые услуги участка сборки и функционального контроля /
Typical services of the assembly and functional control section**

16	Односторонний торцевой/вертикальный монтаж волоконного вывода без корпуса на УФ адгезив по мощности оптического излучения / Single-sided end-face/vertical mounting of fiber optic lead without housing on UV adhesive by optical power	1 образец / 1 sample	97 000.00
17	Двусторонний торцевой/вертикальный монтаж волоконного вывода без корпуса на УФ адгезив по мощности оптического излучения / Double-sided end-face/vertical mounting of fiber optic lead without housing on UV adhesive by optical power	1 образец / 1 sample	111 900.00
18	Односторонний торцевой/вертикальный монтаж волоконного вывода в корпусе на УФ адгезив по мощности оптического излучения / Single-sided end-face/vertical mounting of fiber optic lead in housing on UV adhesive by optical power	1 образец / 1 sample	116 400.00
19	Двусторонний торцевой/вертикальный монтаж волоконного вывода в корпусе на УФ адгезив по мощности оптического излучения / Double-sided end-face/vertical mounting of fiber optic lead in housing on UV adhesive by optical power	1 образец / 1 sample	124 400.00
20	Квазипланарный монтаж волоконного вывода без корпуса на УФ адгезив по мощности оптического излучения / Quasi-planar mounting of fiber optic cable without housing on UV adhesive by optical power	1 образец / 1 sample	124 100.00
21	Сварка оптических волокон. Диаметр оболочки: 125 мкм. Защитное покрытие: акрилат. Диаметр в акрилатном покрытии: 245 мкм. Стандартные программы сварки Fujikura FSM 100P+ / Splicing of optical fibers. Cladding diameter: 125 µm. Protective coating: acrylate. Diameter in acrylate coating: 245 µm. Fujikura FSM 100P+ Standard Welding	1-5 сварных соединений / 1-5 welded joints	5 000.00
22	Изготовление волоконного зонда с высокоапертурным ОБ. G652D + UHNA7/UHNA4. Защитное покрытие: акрилат.	1 шт. / 1 pcs.	11 800.00

	<p>Длина зачищенного участка: > 3 мм. Подготовка торца зонда: скол под прямым углом / Manufacturing of a fiber probe with a high-aperture optical fiber. G652D + UHNA7/UHNA4. Protective coating: acrylate. Stripped length: > 3 mm. Probe end preparation: cleaved at a right angle.</p>		
23	<p>Угловая полировка оптических волокон с/без ориентацией вокруг оси волокна. Диаметр кварцевой оболочки: 125 мкм. 0-45 градусов между осью волокна и плоскостью отполированного торца / Angular polishing of optical fibers with/without orientation around the fiber axis. Quartz cladding diameter: 125 µm. 0-45 degrees between the fiber axis and the polished end plane</p>	1 шт. / 1 pcs.	14 000.00
24	<p>Изготовление конусных линзированных волокон. Угол раскрытия конуса: 90° / Manufacturing of conical lensed fibers. Cone opening angle: 90°</p>	1 шт. / 1 pcs.	22 600.00
25	<p>Монтаж оптического волокна в капилляр. Длина капилляра: >8 мм. УФ-отверждаемый адгезив / Mounting optical fiber into a capillary. Capillary length: >8 mm. UV-curable adhesive</p>	1 шт. / 1 pcs.	18 500.00
26	<p>Полировка торцевой поверхности чипа. КНИ, нитрид кремния. Угол полировки: 0° ; 8°. Размер чипа (ширина): 10x10 мм или 5x5мм / Polishing the chip end surface. SOI, silicon nitride. Polishing angle: 0°; 8°. Chip size (width): 10x10 mm or 5x5 mm</p>	1 торец / 1 end surface	33 900.00
27	<p>Разработка специализированной программы сварки оптических волокон / Development of a specialized optical fibers welding program</p>	1 рабочий день / 1 work day	34 000.00
28	<p>Разработка специализированного режима полировки чипов / Development of a specialized chip polishing mode</p>	1 рабочий день / 1 work day	70 700.00
29	<p>Проведение зондовых измерений (пластина, кристалл). Вертикальный и торцевой ввод/вывод. Зонды: одиночные волокна (125 мкм), многоканальные массивы (ширина 6 мм) / Carrying out probe measurements (wafer, crystal).</p>	1 рабочий день / 1 work day	104 600.00

	Vertical and end-face input/output. Probes: single fibers (125 μm), multichannel arrays (6 mm wide)		
30	Проведение зондовых измерений (пластина, кристалл). Оптический, электрический сигнал. Вертикальный и торцевой ввод/вывод. зонды: одиночные волокна (125 мкм), многоканальные массивы (ширина 6 мм), DC-зонды / Carrying out probe measurements (wafer, crystal). Optical, electrical signal. Vertical and end-face input/output. Probes: single fibers (125 μm), multichannel arrays (6 mm wide), DC probes	1 рабочий день / 1 work day	120 700.00
31	Проведение зондовых измерений (пластина, кристалл). Оптический, электрический сигнал. Вертикальный и торцевой (кристалл) ввод/вывод. зонды: одиночные волокна (125 мкм), многоканальные массивы (ширина 6 мм), РЧ-зонд / Carrying out probe measurements (wafer, crystal). Optical, electrical signal. Vertical and end (crystal) input/output. Probes: single fibers (125 μm), multichannel arrays (6 mm wide), RF probe	1 рабочий день / 1 work day	177 900.00
32	Поверхностный монтаж по технологии Chip on board на токопроводящий адгезив или пайку / Surface mounting using chip-on-board technology with conductive adhesive or soldering	1 услуга / 1 service	20 700.00
33	Поверхностный монтаж по технологии flip-chip на токопроводящий адгезив, УФ адгезив, термкомпрессию или пайку. Опционально в инертной среде / Surface mounting using flip-chip technology with conductive adhesive, UV adhesive, heat compression or soldering. Optionally in an inert environment	1 услуга / 1 service	38 400.00
34	Изготовление специализированного волоконного зонда с выставлением положения осей поляризации / Manufacturing of a specialized fiber probe with adjustable polarization axes	1-4 шт. / 1-4 pcs.	283 000.00
35	Услуги по изменению формы стеклянной оправки оптических волокон / Optical fiber glass mandrel reshaping services	1 массив / 1 array	23 900.00
36	Проволочная разварка интегрального чипа на печатную плату или в корпус / Wire bonding of	1 рабочий день / 1 work	55 100.00

	an integrated chip to a printed circuit board or into a housing	day	
--	---	-----	--

При выполнении работ, выходящих за рамки типовых услуг, стоимость выполнения работ, обработки экспериментальных результатов и подготовки научно-технического отчета обсуждается согласно задачам, поставленным в ТЗ на выполнение работ. / When performing work that goes beyond the scope of typical services, the cost of performing the work, processing experimental results, and preparing a scientific and technical report is discussed in accordance with the tasks set in the specification.

¹ В отдельных случаях по согласованию с Исполнителем могут применяться технологические подложки и/или расходные материалы, предоставленные Заказчиком. / In certain cases, by agreement with the Contractor, technological substrates and/or consumables provided by the Customer may be used.

² В отдельных индивидуальных случаях возможно применение особой скидки, зависящей от длительности/объемов работ. / In certain individual cases, a special discount may be applied, depending on the duration/amount of work.

Идентификатор документа, задачи / ID: 453049 v.1, 409241

Skoltech

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ /
The document is signed with a simple electronic signature

Подписал: сотрудник / Signed: employee

Денисов Алексей Алексеевич / Denisov Alexey Alexeevich

Дата и время подписания / Date and time of signing 15.06.2026 10:12:34 GMT +03:00

Подпись соответствует файлу документа /

The signature corresponds to the document file Страница 7 из 7 / Page 7 from 7